

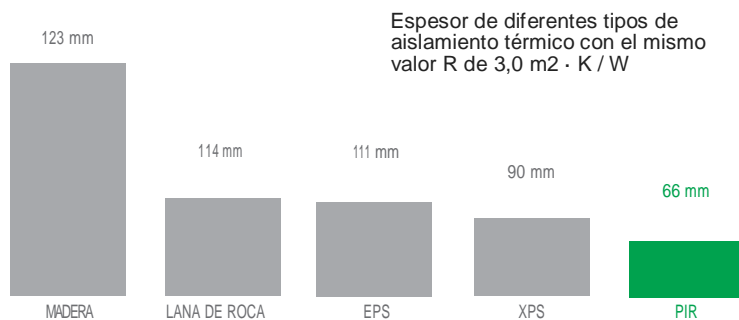


LOGICPIR

LÁMINAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

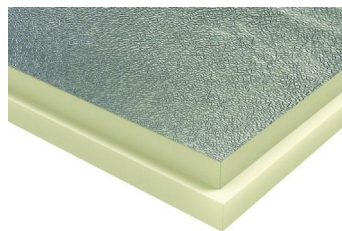
LOGICPIR es una lámina hecha de PIR rígido (Polyisocyanurate) para el uso en sistemas de techados planos. Al ser muy rígida y perfectamente plana, LOGICPIR es un sustrato ideal para materiales de techado, especialmente para membranas sintéticas. LOGICPIR tiene alta resistencia a la compresión y un valor de conductividad térmica muy bajo, de $0,022 \text{ W / m} \cdot \text{K}$.

Más del 95% de las láminas PIR consisten en células cerradas, éstas no absorben agua y mantienen sus parámetros estables durante largos periodos de tiempo.



DATOS TÉCNICOS

Espeor, mm	20-250 (múltiplos de 10)
Tamaño, mm	1200x600, 2400x1200
Conductividad Térmica, $\text{W/m}^2\text{K}$	0,022
Reacción al fuego	Class E
Resistencia a la compresión, kPa	120
Absorción de agua a largo plazo, %	1
Tipo de superficie	Aluminio o Fibra de Vidrio



LOGICPIR
superficie de aluminio



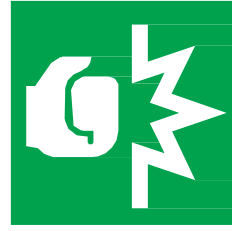
LOGICPIR
Superficie de fibra de vidrio

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LOGICPIR



FIABILIDAD Y DURABILIDAD

Durante los 25 años de vida útil LOGICPIR conserva todas sus cualidades. Funciona eficazmente entre -65 °C y + 100°C, por lo que es adecuado para su uso en cualquier clima.



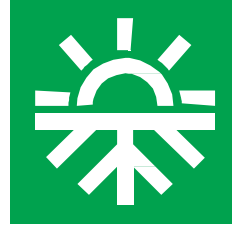
RESISTENCIA DE CARGA DINÁMICA

LOGICPIR cumple los requisitos de la clase 2 para cargas dinámicas (EN 826). La fuerza de compresión de 120 kPa proporciona una alta resistencia a la deformación.



NO ABSORBE AGUA

La estructura de la lámina consta de células rígidas cerradas que impiden la entrada de agua en el material. Los revestimientos compuestos (hechos de papel de aluminio y plástico) proporcionan una barrera de vapor adicional.



CONDUCTIVIDAD BAJA RECORD

LOGICPIR tiene muy baja la conductividad térmica (0.022 W/m*K). Las láminas están machihembradas, por lo que se fijan firmemente evitando así los puentes térmicos.



NO INFLAMABLE

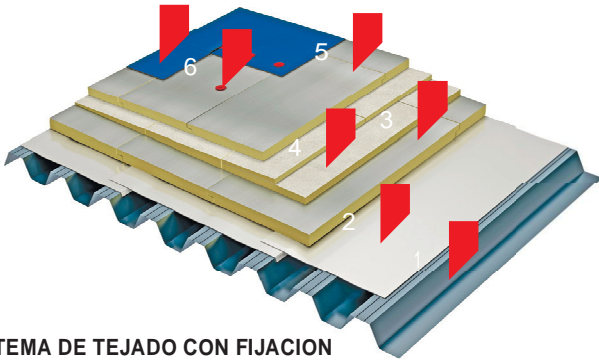
LOGICPIR no es inflamable. Cuando entra en contacto con las llamas, el polímero se quema solo superficialmente. Esto crea una capa de carbón, que es una eficaz defensa contra el daño polimérico adicional.



BAJA DENSIDAD

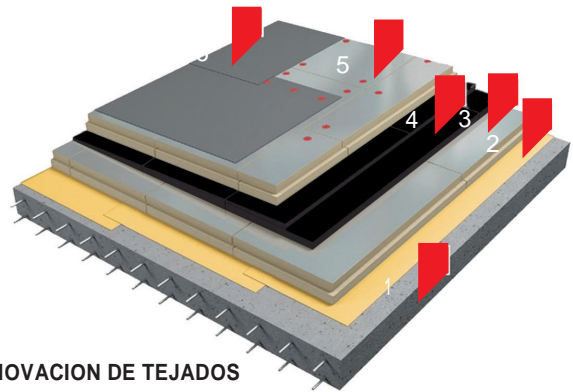
La baja densidad térmica de LOGICPIR se combina con una alta resistencia térmica. El uso de este producto hace disminuir el peso total del tejado (de gran importancia en la renovación de tejados) así como los costos de transporte.

SISTEMAS DE TECHADO



SISTEMA DE TEJADO CON FIJACION MECANICA

1. Base (chapa de acero corrugado)
2. Barrera contra el vapor
3. Lamina de aislamiento térmico LOGICPIR
4. Lamina de aislamiento térmico LOGICPIR Slope
5. Lamina de aislamiento térmico LOGICPIR
6. Fijación mecánica
7. Membrana LOGICROOF V-RP



RENOVACION DE TEJADOS

1. Base (hormigón reforzado)
2. Barrera contra el vapor
3. Aislamiento térmico
4. Membrana bituminosa
5. Lamina de aislamiento térmico LOGICPIR
6. Membrana LOGICROOF V-RP

